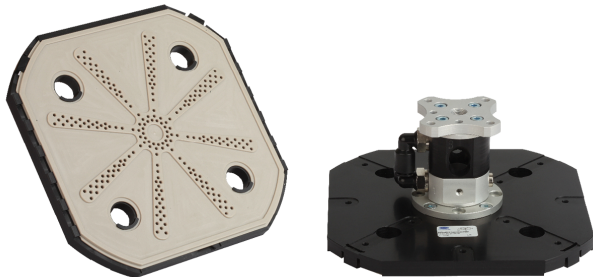
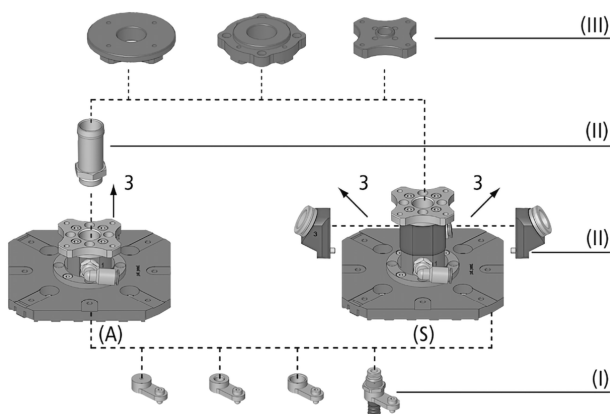


Pinze di presa per wafer SWGm Wet



Pinze di presa per wafer SWGm Wet



Design Pinze di presa per wafer SWGm Wet

Prodotti punti di forza

- Punti di aspirazione appositamente posizionati e dimensionati consentono una manipolazione sicura delle cialde umide
- Manipolazione estremamente veloce e precisa grazie all'altezza e al peso ridotti
- L'alta capacità di aspirazione permette una presa sicura anche in caso di occupazione parziale o di perdite, ad esempio con cialde perforate
- Lo scarico controllato dell'aria aspirata previene la contaminazione dell'area di processo
- La funzione di sgancio rapido permette un posizionamento preciso dei wafer

Idonei per applicazioni specifiche del settore

Applicazione

- Pinza per wafer per una manipolazione estremamente veloce, affidabile, precisa e delicata dei wafer bagnati in applicazioni da banco bagnato
- Movimentazione di wafer dopo processi di trattamento con acido e di pulizia
- Processi di carico e scarico dal nastro trasportatore
- Produzione di celle solari in silicio interamente o parzialmente automatizzata con la massima stabilità di processo, tempo di attività della linea di produzione, efficienza delle celle e rendimento della linea

Struttura

- Modello base in versione con aria di scarico (3) assiale (A) o laterale (S)
- Geometrie della superficie di aspirazione selezionabili per misure celle comuni da 125 mm e 156 mm
- Componente opzionale per scarico controllato (II)
- Struttura modulare con accessori per il montaggio di sensori e modulo di aspirazione e smorzamento (I) e una selezione di moduli flangiati (III)
- Altezza di montaggio minima grazie alla struttura in plastica dal peso ridotto
- Superfici di contatto intercambiabili

Pinze di presa per wafer



Pinze di presa per wafer SWGm Wet

Dati di ordinazione Pinze di presa per wafer SWGm Wet

Tipo	N. articolo
SWGm-6S W 146x146x65 PEEK	10.01.30.00191
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK	10.01.30.00193